

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除[編纂]開支後，我們將收到[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件指示性[編纂]的中位數）。我們擬將[編纂]淨額用於以下用途（按本文件所述[編纂]範圍的中位數計）：

研發

約[編纂]%或[編纂]港元將用於持續提升我們的研發能力和IMSS產品解決方案供應，包括：

CIM產品功能及解決方案

約[編纂]%或[編纂]港元將用於強化我們的CIM產品功能及解決方案，旨在打造適用於國內外客戶的國內開發的12寸前道CIM系統，並確保我們CIM系統的穩定運行及廣泛採用。具體而言，我們計劃通過以下舉措提升項目質量、增加項目成功率及提高我們的市場認可度：

- 建立一支高素質的研發團隊，能夠開發出與國際接軌的12寸前道CIM產品和解決方案。
- 改善智能計算中心的基礎設施，提升其算力及資源配置能力，為我們的項目研發及運營提供更強大的技術硬件支持；及
- 構建MES大模型能力，融合人工智能、機器學習技術，提升智能算力及服務水平。

我們計劃在未來兩年內為我們的研發團隊招聘26名人員專門負責此項工作。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
產業顧問.....	6	本科或以上學歷；及具有智能製造、CIM軟件及MES／自動化實施等經驗。	10年以上。	[編纂]
軟件架構師.....	6	計算機科學或相關領域的本科或以上學歷；及深入了解主流數據系統原理、源代碼和數據庫。	8年以上大數據行業經驗；及5年以上大數據架構設計經驗。	[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
軟件開發工程師	6	本科或以上學歷；精通Java程序設計、主流系統架構、應用中間件及運維。	5年以上。	[編纂]
質量經理	6	機械、電子、材料、質量管理或相關領域的本科或以上學歷；熟悉軟件質量保證程序及數據分析工具；及項目管理方面的專業知識和方法。	5年以上軟件及／或硬件開發企業質量管理的經驗。	[編纂]
研發經理	2	本科或以上學歷；及具備管理研發中心或實驗室的經驗。	10年以上。	[編纂]

我們計劃將我們的研發團隊安置在中國及海外的多個地點，這符合可用的人才儲備及我們的海外擴張戰略。詳情請參閱下文「— 新增辦公室及實驗室」。

我們將在未來三年內購買額外的硬件及軟件以支持研發團隊，其中包括助力開發及測試指定產品及平台的新服務器及算力卡，以及額外電腦設備用於一般開發及測試目的。

AI應用

約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設我們在泛半導體行業的AI應用能力。利用AI和大模型能力，我們的目標是打造統一的人工智能製造中央控制平台，使LOFA AI及其他AI產品能夠取代現場操作人員，擔任工程師助手及通過生產流程的智能自動化，協助管理層快速決策。我們計劃擴展LOFA目前針對現場操作人員的功能，使其涵蓋工程輔助和管理輔助功能。這就需要結合人工智能和大模型的能力，打造一個獨立的工業人工智能模型。

具體而言，我們計劃通過以下舉措升級及優化我們的LOFA及其他AI產品：

- 建立LOFA及其他AI工廠行業知識庫模型，強化LOFA產品應用場景，從單純提升現場作業能力發展為優化與工程師的協同決策；
- 開發多個管理模塊升級LOFA及其他AI產品，提升產品開發和模塊化部署能力；
- 成立計算應用，建立我們的數據集，構建軟硬件相結合的一體化研發平台，供LOFA及其他AI產品使用；及
- 組建集泛半導體行業經驗、現場經驗、AI技術能力、軟件開發能力於一體的內部研發團隊。

未來計劃及[編纂]用途

我們計劃在未來兩年內為研發團隊招聘26名人員專注AI應用。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
AI工程師	3	計算機科學、自動化、電氣工程或相關領域的本科或以上學歷；熟練掌握程式語言；及了解機器學習/深度學習並具備數學基礎。	3年以上人工智能／機器學習開發經驗。	[編纂]
產業顧問.....	3	本科或以上學歷；且具有智能製造、CIM軟件及MES／自動化實施、半導體相關產業的工廠建設及工藝經驗。	10年以上。	[編纂]
現場應用工程師	3	電子相關領域的本科或以上學歷；及了解CIM+AI軟件產品。具備部署、故障排除和支持 CIM + AI 軟件產品的專業知識。	3年以上。	[編纂]
軟件平台專家.....	4	計算機科學、電氣工程、自動化或相關領域的本科或以上學歷；及深入了解軟件架構設計原則，並設計及實施可擴展軟件平台架構。	8年以上半導體或相關行業軟件開發經驗。	[編纂]
軟件架構師.....	3	與為提升CIM產品功能及解決方案招聘的研發團隊相同職位具備大致相似的基本遴選標準及經驗年資。		[編纂]
軟件開發工程師	3			[編纂]
質量經理.....	4			[編纂]
研發經理.....	3			[編纂]

我們計劃在中國及海外的不同地點設置相關研發中心及實驗室，安置我們的團隊。詳情請參閱下文「— 新增辦公室及實驗室」。

就我們的AI應用而言，除購買新服務器及算力卡以助力指定產品及平台的開發及測試，以及額外的計算機設備外，我們將在未來三年內獲取行業數據集，以建立訓練數據集，支持在我們的實驗室訓練AI模型。

工藝設計與仿真解決方案

約[編纂]%或[編纂]港元將用於建立高端工藝設計與仿真解決方案開發的研發能力。

未來計劃及[編纂]用途

工藝設計與仿真(PDS)是我們數字化設備平台下的軟件產品之一。這是一款用於優化半導體製造工藝的仿真和校正工具。其指數字化仿真半導體製造步驟(注入、蝕刻、沉積、光刻、熱處理)的工藝建模工具，以在實際流片前預測結果、優化產品參數並縮短開發週期。由於實際的半導體流片非常昂貴、緩慢且重複風險高，仿真技術使半導體設備製造商能夠在浪費晶圓、時間及工具產能之前發現問題。

我們的PDS軟件為泛半導體設備製造商(主要是電子設計自動化)提供綜合服務，涵蓋從芯片設計到晶圓廠設計、光掩模製造仿真，以及為生產光掩模的電子束光刻設備製造商提供校準算法開發服務。

我們自2024年12月起已加大對PDS精細化開發的投入，並通過自研算法，實現了媲美海外行業領導者所掌握技術的校正技術。憑藉[編纂]的預期[編纂]淨額，我們計劃增強高端工藝設計與仿真解決方案開發的研發能力，旨在將我們的電子束仿真與校正能力從目前的50納米工藝提升至7納米節點能力。我們亦計劃拓展應用場景：從電子束光刻(EPC)機器校準的標準產品(為光掩模製造商提供鄰近效應校正(PEC)校準軟件)，拓展至下一階段的佈局校正掩模工藝校正(MPC)軟件，將光刻業務的發展從電子束光刻能力延伸至晶圓廠光學鄰近校正(OPC)及製造工藝仿真的應用。

具體而言，我們計劃將專用於此用途的[編纂]淨額用於以下舉措：

- 開發及優化光學鄰近校正算法，以及增強及擴展鄰近效應校正和霧化效應校正軟件，以幫助我們的客戶實現更精確的光刻工藝控制；
- 進行電子束光刻機相關校正模型的研發，以實現國產設備精度達到國際一流水平；及
- 組建一支由核心半導體製造工藝專家、算法工程師組成的高端工藝設計與仿真產品研發的內部研發團隊。

未來計劃及[編纂]用途

我們計劃在未來五年內為我們的研發團隊招聘19名人員，專門負責該研發。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
AI算法專家.....	4	本科及以上學歷；及具有在半導體製造環境下進行人工智能圖像場景挖掘的經驗。	8年以上機器學習開發經驗；及5年以上的核心深度學習修改經驗。	[編纂]
半導體製程專家.....	4	材料科學與工程、電子科學與技術、微電子、物理電子、化學工程或相關專業的本科或以上學歷；及精通核心半導體製造流程，製造流程及工藝優化。	5年以上工藝研發或半導體12寸晶圓廠的經驗，曾領導過至少一個完整的半導體工藝開發或量產項目。	[編纂]
研發經理.....	3	與為提升CIM產品功能及解決方案招聘的研發團隊相同職位具備大致相似的基本遴選標準及經驗年資。		[編纂]
軟件開發工程師.....	8			[編纂]

為支持我們的高端工藝設計及仿真解決方案開發工作，我們計劃於上海及台灣設立研究及開發中心，以承擔相關職能。詳情請參閱下文「一 新增辦公室及實驗室」。

我們將在未來三年內購買執行其專用職能所需的硬件及軟件，包括新服務器及算力卡及其他額外計算機設備。我們亦計劃租賃生產線產能，專門用於試點測試及仿真活動，以對照實際製造流程驗證電子束仿真算法，並進行必要的校準。

特定行業組件平台

約[編纂]%或[編纂]港元將分配於開發現有產品的特定行業組件平台，以通過以下舉措降低交付成本。

- 建立產品發佈中心，通過該中心管理產品迭代，並實施自動化產品測試，以降低用戶驗收測試成本和人力需求；
- 通過按行業分解現有項目代碼，細化代碼架構，封裝成模塊化組件，通過集中的平台管理，實現行業組件的模塊化；
- 搭建涵蓋產品設計、開發、用戶驗收測試及上市的一體化研發管理平台，精簡優化設計－研發－上市的全流程；及

未來計劃及[編纂]用途

- 發展AI大模型能力，實現產品開發、代碼測試審核、架構框架設計的部分自動化。

我們計劃在未來五年內招募22名額外研發人員及在未來三年內購買額外硬件及軟件，以開發我們現有產品的特定行業組件平台。

下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	基本遴選標準	預期經驗	估計人均年薪 (百萬港元)
軟件開發工程師.....	6	與為提升CIM產品功能及解決方案招聘的研發團隊相同職位具備大致相似的基本遴選標準及經驗年資。		[編纂]
軟件架構師.....	6			[編纂]
質量經理.....	6			[編纂]
研發經理.....	4			[編纂]

儘管由於部分研發人員調配至項目實施團隊，2024年，我們的研發成本有所降低，研發團隊規模也有所縮減，但鑒於(i)上述擴大我們在CIM產品、AI應用、高端工藝設計及仿真解決方案方面的業務能力的需要，以及開發我們特定行業組件平台的需要；(ii)我們於海外增設辦事處及實驗室的計劃；(iii)我們擴大海外銷售網絡的計劃，我們預期將根據上述計劃招聘員工。

新增辦公室及實驗室

約[編纂]%或[編纂]港元將用於租賃及裝修在中國和海外的新增辦公室，作為我們新的研發中心和實驗室，為上述我們的新研發團隊提供場所。

12寸前道CIM產品及解決方案團隊：

我們計劃於2026年租賃位於中國北京、長沙及成都、新加坡、泰國及馬來西亞的物業，以為我們的研發團隊成員提供場所。各中心的總建築面積擬為300平方米至600平方米。

AI應用團隊：

為支持我們的AI應用團隊，我們計劃於未來兩年內成立五個研發中心，分別於上海、深圳、台灣、新加坡及馬來西亞設立；我們亦計劃於2026年在上海、深圳及台灣設立三個專門實驗室以進行平台搭建及算法訓練。我們計劃租賃總建築面積介乎500平方米至800平方米的物業作各研發中心之用；及平均總建築面積為1,100平方米的物業作各實驗室之用。

高端工藝設計及仿真解決方案開發團隊：

我們計劃自2026年中起租賃總建築面積約為1,500平方米的物業，以分別在上海和台灣設立研發中心。

未來計劃及[編纂]用途

設立新增研發中心及實驗室的業務需求及商業理由

本公司計劃在中國多個城市及東南亞部分國家設立合共13個新增研發中心及三個實驗室，乃基於以下業務需求及商業理由：

- **業務目標：**本集團預期通過設立多個研發中心及實驗室達致以下業務目標：(i)迅速響應客戶的現場需求及生產線驗證；(ii)縮短研發及交付週期；(iii)提高產品在具備本地需求及要求的不同地點的適應性及穩定性；(iv)確保技術迭代的速度；及(v)滿足本地及海外客戶的本地化合規及技術支持要求。
- **海外市場**－我們已將越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度及中東確定為我們的主要海外目標市場，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場均對光伏、PCB及半導體產業的全球轉移至關重要。有關我們海外擴張計劃的詳情，請參閱本節下文「一 銷售及推廣」。在新加坡、泰國及馬來西亞設立研發中心與我們的海外擴張計劃有關。

國內市場－根據弗若斯特沙利文的資料，國內半導體及先進製造業表現出高度的區域集中度：長三角（上海、蘇州、無錫、合肥）；珠三角（深圳、廣州、珠海）；京津都市圈；以及中國中西部主要製造基地（成都、長沙、西安、武漢）。因此，本集團指定長三角的上海、珠三角的深圳、北京以及中國中西部的長沙及成都的研發地點作為我們未來研發計劃的區域基地。

鄰近產業：在鄰近我們下游核心產業集群及目標市場的地點設立研發中心及實驗室，可達致較短的交付及響應週期，因為我們將能夠在項目開發、安裝、生產線調試及聯合測試階段解決項目及產品技術問題，從而提高項目驗收效率，提高客戶忠誠度，並加強獲取訂單的能力。

- **增強測試及驗證能力：**我們的軟件產品及解決方案需要軟件與硬件的深度整合，因此需要在真實的生產線環境中進行反覆驗證。研發實驗室旨在構建仿真生產線環境，完成設備整合及兼容性測試，從而提高產品推出的成功率，並降低交付後的缺陷率及返工成本。
- **人才招聘：**在多個地點設立多個研發中心及實驗室有助於招聘一支高素質、高端的研發人才團隊以支持我們的研發發展。根據弗若斯特沙利文的資料，半導體、工業軟件、AI算法及CIM系統屬於高端硬科技領域，人才高度集中在中國核心城市及台灣等地區。在多個地點設立研發中心可以擴大招聘人才的覆蓋範圍，降低跨城市／國家招聘的人力資源成本，穩定研發團隊，並降低員工流失率。

此外，儘管部分研發中心及實驗室將位於相同的城市、地區或國家，我們旨在實現多個產品線之間的專業分工並避免資源衝突。跨越多個產品線的並行研發容易導致

未來計劃及[編纂]用途

資源競爭及效率下降。通過多個研發中心及實驗室，我們旨在為每個研發中心及實驗室分配側重一至兩個核心技術方向的特定主題，以實現專業化及精細化研發，提高研發質量及交付速度。

現有及新研發中心以及預期研發能力的提升

我們目前的四個研發中心專注於不同的職能與領域，即：

- (i) 聯合實驗室中心主要負責開發新軟件產品及解決方案；
- (ii) 產品開發中心主要負責按個別基準對我們現有軟件產品進行升級及進一步開發；
- (iii) 核心研發中心主要負責開發及升級我們的平台，專注於技術突破；及
- (iv) 解決方案諮詢中心主要負責根據客戶需求設計最佳軟件解決方案並追蹤其實施情況。該中心與我們的業務部門及銷售團隊合作，解決以客戶為導向的項目及產品需求。

詳情請參閱「業務－研發－研發能力及中心」一節。

根據我們對[編纂][編纂]淨額部分擬定用途的未來計劃，我們的新研發中心及職能部門針對三個領域進行量身定制及具體規定，即

- (i) 加強我們的CIM產品功能及解決方案，擴張及擴大我們的業務規模以服務更多12寸製造設備廠，以滿足納米級精密工廠的需求；
- (ii) 建立我們在泛半導體行業的AI應用能力，並結合CIM產品場景的綜合開發。具備此職能的新研發中心將專注於開發及拓展AI智能體訓練的算力，以建立我們專有的工業AI模型，從而提升產品能力並支持前道工廠將其能力從替代人工升級至協助工程師及管理人員進行決策，最終提高工廠效率；及
- (iii) 建立我們的高端工藝設計與仿真解決方案開發的研發能力，專注於物理模型及仿真效果對比的具體研究及實驗。

鑒於上文所述，現有的四個研發中心並無獲分配特定的產品或主題作研發用途，其功能、價值及研發成果服務於本集團整體的產品開發及業務運營；而即將設立的新研發中心及實驗室將專注於符合我們未來計劃及戰略的特定研發主題。

我們旨在通過專注於上述將在新研發中心及實驗室實現的研發主題，實現以下研發能力的提升：

- (a) 將我們用於12寸晶圓製造的MES場景覆蓋能力從目前內部評估的63分提升至內部評估的85分以上；

未來計劃及[編纂]用途

- (b) 通過建立具競爭力的CIM + AI優勢，目標是我們的產品應用場景中AI的年整合率達到15%；及
- (c) 將我們的電子束仿真與校正能力從目前的50納米工藝提升至7納米節點能力。

戰略合作

約[編纂]%或[編纂]港元將用於選擇性地尋求國內外戰略聯盟、投資、併購機會。在評估投資或收購機會時，我們將主要考慮能與我們的產品組合互補、且符合我們的企業理念與發展策略的目標公司。我們的潛在目標包括工業AI和生態整合領域的公司，以及其他能讓我們探索新的市場機會，並擴展我們在泛半導體行業足跡的公司。通過與該等公司的戰略併購，我們預期將在工業AI及生態整合領域建立穩固地位，從而提升我們在泛半導體IMSS市場的市場份額。

我們的收購策略採用定量挑選標準，目標為市值介於160百萬港元至240百萬港元之間、淨利率約為10%、且連續兩年盈利能力良好的公司，並結合定性評估技術協同效應和市場准入潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，中國工業軟件行業存在約200個合適目標，主要集中於華東地區。董事認為，該等已完成收購預期將於整合後12個月內增加盈利，貢獻每年約50百萬港元至200百萬港元的增量收入，同時維持本集團整體毛利率在15%以上；然而，該等交易可能暫時增加整合期間的行政費用，並可能因預付代價而對短期現金流造成不利影響，本集團擬透過內部資源及[編纂][編纂]的組合提供資金。截至最後實際可行日期，我們尚未物色任何潛在的收購目標。經考慮尋找合適的投資或收購目標、進行必要的評估和盡職審查以及與交易對手商定投資或收購的商業條款所需的時間，我們預計目標投資或收購將於2027年年底進行並完成。

銷售及推廣

約[編纂]%或[編纂]港元將自2026年起用於提升我們的商業化能力，通過以下舉措擴展國內外銷售與服務網絡，以及提升客戶服務質量以維持並深化現有客戶關係：
(i) 擴充國內外銷售與服務團隊；及(ii) 支持本土化營銷與品牌推廣活動來進一步提升我們品牌的知名度，擴大我們的客戶群。具體而言，我們將定期參與國內外展會活動以及行業會議和研討會，並開展營銷活動以向潛在客戶推廣我們的IMSS。

未來計劃及[編纂]用途

我們計劃於未來兩年內為我們的銷售及服務團隊招聘30名人員。下表載列我們計劃招聘的人員明細：

職位	人數	角色及職能	預期經驗及資質	估計人均年薪 (百萬港元)
營銷副總裁.....	1名	負責完善本集團的銷售及營銷體系、制定營銷策略以及建設銷售及服務團隊。	在工業軟件、CIM、MES及自動化行業擁有逾八年營銷管理經驗。	[編纂]
銷售總監.....	2名	負責制定及執行銷售策略，帶領獲取主要客戶，發展銷售基礎設施並提供定期管理分析。	在工業軟件營銷方面擁有逾五年經驗，具備泛半導體、PCB、顯示面板或光伏產品方面的經驗。	[編纂]
銷售經理.....	15名 (1名負責馬來西亞市場，2名負責印度市場，12名負責中國市場)	負責區域或特定行業的市場拓展，維護客戶關係以推動向上銷售及交叉銷售的機會。	在泛半導體、PCB、顯示面板或光伏產品方面擁有逾三年經驗。	[編纂]
市場運營專員...	10名 (2名負責新加坡市場，8名負責中國市場)	負責銷售及服務團隊的日常運營及區域銷售活動的協調。	擁有一至兩年行業經驗及市場營銷、工商管理及客戶服務學士學位。	[編纂]
營銷專員.....	2名負責中國市場	負責協調展會推廣工作、管理客戶線索收集並促進銷售跟進。	在B2B(企業對企業)營銷方面擁有逾兩年經驗，具備市場營銷、傳媒及電子學士學位	[編纂]

儘管於2025年，完善我們的銷售團隊架構以將我們的資源集中於高效能人員，導致我們的銷售團隊規模有所縮減，但我們的銷售團隊擴張計劃專注於招募能夠管理全自動12寸晶圓生產線相關複雜銷售週期的營銷專員。為促進我們滲透國內外泛半導體

未來計劃及[編纂]用途

體IMSS市場，我們需要能夠獲取頂級客戶訂單且具備整合諮詢與提供IMSS系統的銷售方法知識的營銷專業人員，這對於進入海外市場至關重要。我們的招聘計劃與已核實的潛在商機直接相關。自2026年1月1日起至最後實際可行日期，我們已在印度、越南、馬來西亞、泰國及韓國等國家確定39個潛在商機，這證明了我們擴充銷售團隊以滿足當地需求的合理性。

海外擴張計劃方面，我們已將越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度及中東確定為我們的主要海外目標市場，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場對光伏、PCB及半導體產業的全球轉移均至關重要。我們已完成對目標市場的區域產業結構、客戶分佈及競爭格局的全面評估並已對目標市場進行詳細的可行性研究，分析行業發展趨勢、在建或計劃中的工廠、人工成本及當地制度。有關我們海外擴張計劃的詳情，請參閱「業務－我們的策略－利用我們的智能製造技術加速海外佈局」及「業務－盈利途徑－擴大客戶群」。

2025年8月，我們於東南亞訂立了我們的首個海外項目，合約總額約6.7百萬美元，涉及跨平台系統模塊。該項目不僅展示了我們承接複雜跨境項目的能力，也為我們拓展全球業務奠定了堅實的基礎。於2025年，我們與海外客戶訂立若干合約，包括在印度執行全廠CIM項目的工作訂單、在印度尼西亞、越南和埃及的太陽能生產線項目、台灣客戶的MCS項目。於最後實際可行日期，我們正與海外半導體封裝／測試客戶磋商，並正在探索台灣地區市場設施數字化項目，其中一些項目已進入合約最終確定和實施階段，這證實了明確且可行的海外需求。

營運資金

約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。倘[編纂]淨額高於或低於預期，則我們將就以上用途按比例增加或減少[編纂]淨額的分配。

倘[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）計算，並扣除本公司應付的[編纂]費用及佣金後，本公司將就因[編纂]獲悉數行使而將予配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元。額外籌集的款項將按比例用於上述[編纂]用途。

倘我們發展計劃的任何部分因各種原因而未能如期進行，如政府政策的變動導致我們的任何計劃發展不再可行，或發生不可抗力事件，我們將審慎評估形勢及或會重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途，我們會將未使用的[編纂]存入持牌商業銀行或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。